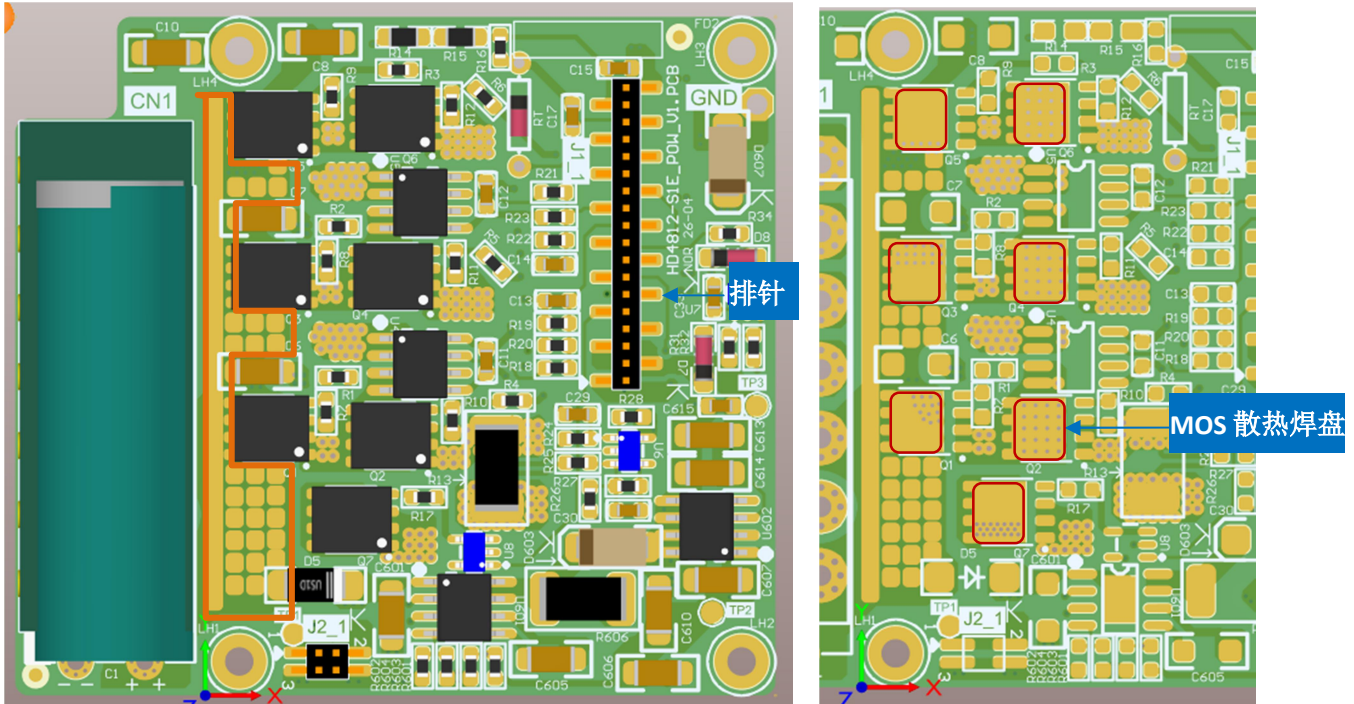


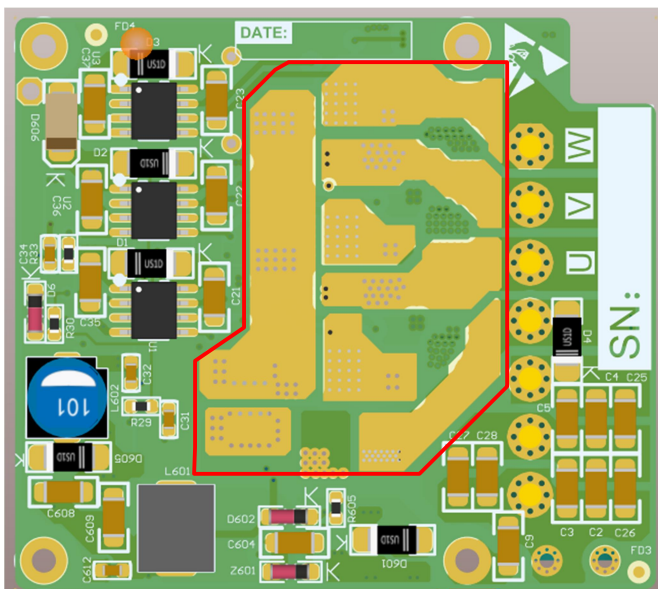
PCB 焊接 工艺要求	产品名称	产品型号	工序	文件编号	版本	页数	制订时间
	直流伺服	HD4812-S1E_POW_V1	焊接	QM03326040201	V1	1/1	20260402

1. 顶层:



- 1) 上图橙色标注位置(即除元件焊盘外, 所有裸露焊盘[露铜位置]进行加锡), 框内 PAD 加锡, 加锡厚度为 0.2mm
- 2) 功率管 Q1~Q7 共计 7 个 (PDFN5\*6-8L 封装的 MOS) 焊接, 要求功率管本体边角与 PCB 的白色丝印限位框角对齐, 严格按照丝印的标识定位焊接; 【注: 若是手工焊接, 需要提前在 MOS 散热焊盘加锡, 用热风枪焊接, 严禁 MOS 底部焊盘冷焊及虚焊】
- 3) C1 (390uF/100V (13\*35) 引线), 折弯 90 度, 其管脚套热缩管焊接

2. 底层



※【红色】框内露铜走线, 尽可能不让顶层焊锡漏至底层【即使漏至底层, 高度要控制在 0.1 以下, 故顶层 MOS 散热焊盘加锡要恰到好处, 不多也不少】

3. 所有排针排母焊接, 需要压到底焊接, 不接受歪扭, 偏差要小于 0.3mm;

4. 未特殊说明的参见《IPC-A-610E 电子组件的可接受性》标准;

编制		审核		批准	
日期		日期		日期	